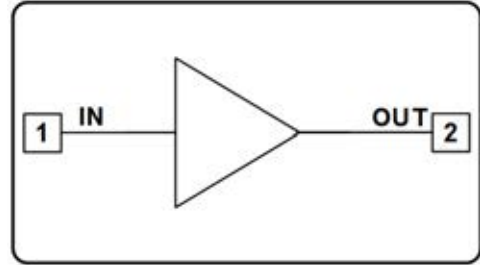




主要特点

- 工作频段: DC - 2 GHz
- 增益: 23 dB
- 噪声系数: 1.5 dB
- 直流供电: 5 V / 95 mA
- 反向隔离: 30 dB
- P1dB: +23 dBm
- 芯片尺寸: 1.0 × 0.85 × 0.1 mm³

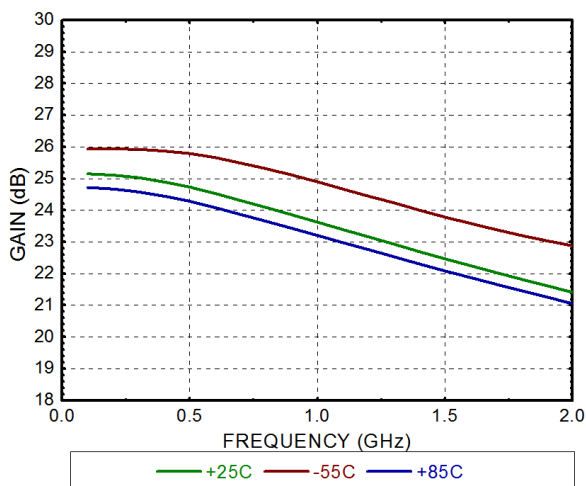
功能框图



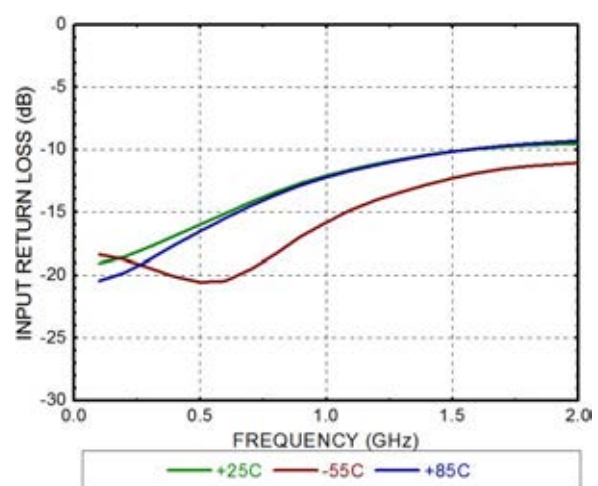
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, 5 V / 95 mA)

参数	最小	典型	最大	单位
工作频段	DC - 2			GHz
增益		23		dB
输入回波损耗		17		dB
输出回波损耗		20		dB
反向隔离度		30		dB
输出功率 1dB 压缩点		23		dBm
噪声系数		1.5		dB
工作电流	70	95	130	mA

增益

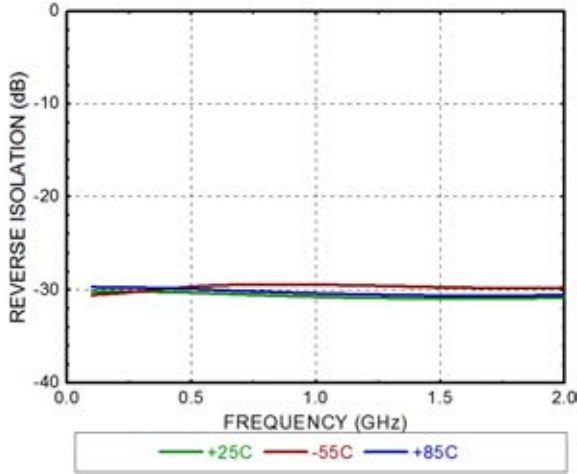


输入回波损耗

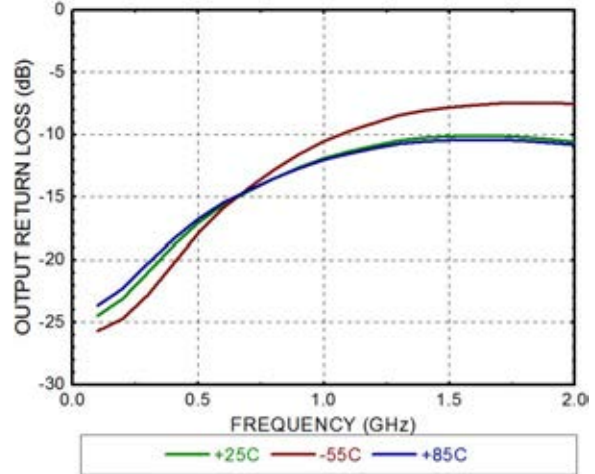




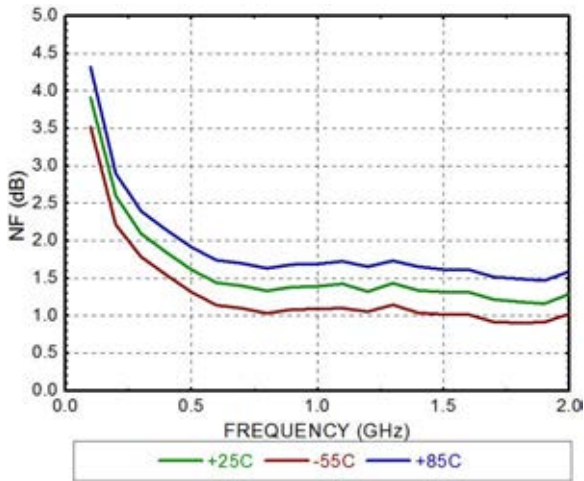
反向隔离



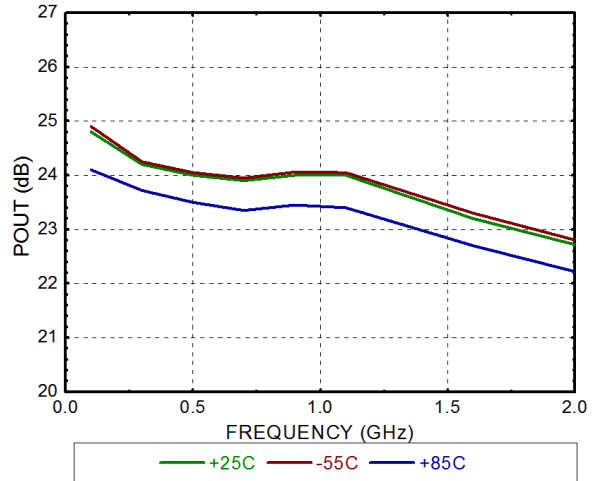
输出回波损耗



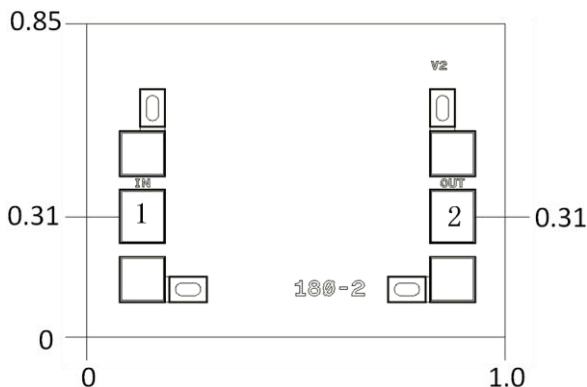
噪声



输出功率P1dB



物理参数

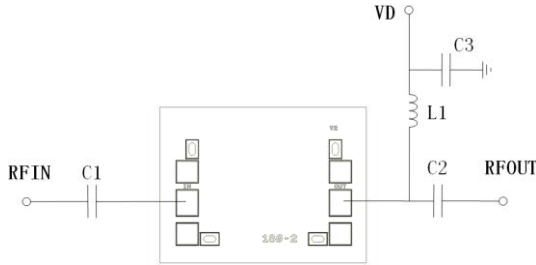


焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 DC 耦合，片上无隔直电容，匹配至 50 Ohm
2	OUT	该焊盘是 DC 耦合，片上无隔直电容，匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



推荐偏置电路



元件	功能	起始工作频率		
		100MHz	1GHz	2GHz
L1(nH)	射频扼流线圈	270	68	22
C1/C2(pF)	隔直电容	1000	100	100
C3(pF)	去耦电容	1000		

极限参数

射频输入功率: +17 dBm

储存温度: -65 ~ +150 ℃

输出端口供电: +6 V

工作温度: -55 ~ +85 ℃